

精密自动加热伺服压力机

货号: KT-SF



简介

专为严苛的材料测试而设计，这款高精度自动加热伺服压力机提供高达1吨的闭环力控制、独立的双压板加热（最高可达300摄氏度）、循环水冷却以及用于研究实验室的可编程触摸屏自动化功能。

了解更多

应用	描述	主要优势
固态电池组装	在受控压力下对固体电解质膜、锂金属箔和复合阴极层进行高精度热固结。	通过均匀的低吨位压缩和加热，消除界面空隙的形成并优化离子电导率。
薄膜聚合物层压	在高达 300°C 的温度下对多层热塑性塑料、含氟聚合物和聚酰亚胺薄膜进行热熔合和压缩，并进行均匀的热浸泡。	通过微力伺服下降和精确的压板平行度防止空气滞留和表面起皱。
热压印与微复制	将微流控通道、光学微结构和微米级织构压印到环烯烃共聚物和 PMMA 基板中。	高位移重复性和可编程保压循环确保了亚微米特征保真度，而基板不会破裂。
复合试样制备	用于机械表征的纤维增强聚合物测试样品、预浸料层压板和高级预制件的固化和固结。	双板独立斜坡升温可防止树脂挤出，同时加速完全热基质交联。
半导体芯片底部填充与封装	先进电子封装基板、热界面材料 (TIM) 和底部填充树脂的热固化和热压调平。	精确的 ± 1 公斤压力调节保护脆弱的硅芯片、微凸点和引线键合免受机械冲击。
功能陶瓷生坯压实	将专用的压电、介电和结构陶瓷粉末单轴加热低吨位压成均匀的压实件。	提供一致的生坯密度分布，而没有压力峰值，减轻烧结变形和分层。
实验室 XRF 和 FTIR 压片制备	用于分析光谱的易碎粉末混合物、粘合剂材料和聚合物混合物的压实和热固结。	清洁的无油操作可防止光谱污染，而可编程加载可产生高度可重复的光学盘。

参数	技术规格
设备型号代码	KT-SF
工作压力范围	0 – 1 吨 (伺服电机驱动加压)
压力控制精度	± 1 公斤
压力控制模式	全可编程压力和保持保压控制
压板工作温度范围	环境温度至 300 °C
加热控制架构	双板独立可编程控制带斜坡
加热功率	1500 W
压板尺寸	150 毫米 × 150 毫米
最大压板间隙距离	50 毫米
压板冷却方法	集成循环水冷却
操作员界面与控制器	7 英寸工业触摸屏控制器

参数	技术规格
主电源要求	交流 220 V / 60 Hz
合规与安全认证	CE 标志
机械致动类型	清洁机电伺服驱动丝杠机构
机架外壳配置	带有前部保护屏障的台式独立单元